

### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块

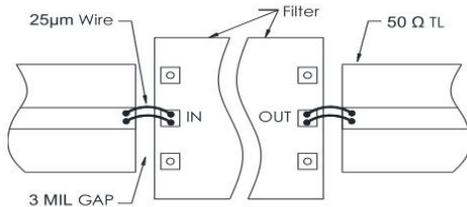
### 技术要求, $T_A=25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		24.0		GHz
工作频率	23.5		24.5	GHz
中心损耗		2.4	2.9	dB
带内波动		0.6	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-22.2GHz	55	60	dBc
	@25.9-31.0GHz	55	60	dBc

### 环境要求

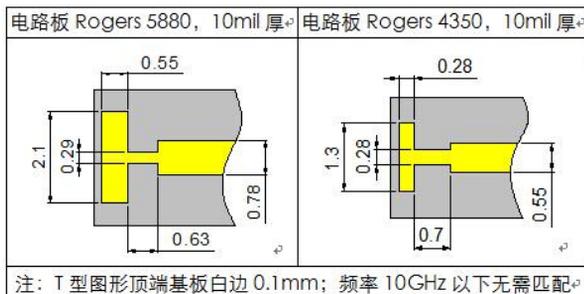
最大输入功率	30	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C}\sim+85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C}\sim+125^\circ\text{C}$	

### 推荐装配图

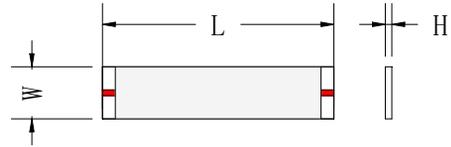


### 注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁**0.1mm**, 表面距上盖**1.75mm**, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/°C), 载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配, T型尺寸如下:



### 外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	6.0	3.0	0.254	mm

### 典型曲线, $T_A=25^\circ\text{C}$

